

# 第二十三届中国覆铜板技术研讨会

## 邀请书

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，原定于2022年11月10日至11月12日举行的“第二十三届中国覆铜板技术研讨会”，因疫情影响一再推迟，现定于**2023年2月16日至2月18日**，在江苏省南通市海安市“海安王府邦瑞国际大酒店”举办“第二十三届中国覆铜板技术研讨会”。

当前国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓，国内经济形势面临下行压力，市场需求收缩。新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，覆铜板产业已迈入创新突破高质量发展新时代，产品实现迭代升级，企业需加大自主创新力度，需要产业链上下游加强技术合作，开放包容、互惠共享，共同推进覆铜板产业技术创新突破，促进产业链健康持续发展。

本届研讨会的主题为“**加强技术创新 驱动产业链健康发展**”。大会将邀请覆铜板行业及其上下游企业、科研院所的知名专家，就覆铜板技术及产业链的热门话题作深入探讨和精彩演讲，还有来自国内覆铜板行业及上下游行业的专家、技术人员呈献的优秀论文。大会召开期间，将隆重颁发本届研讨会的“CCLA杯优秀论文奖”。

**热忱欢迎覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。**

**热忱欢迎关注覆铜板产业发展的各界人士、机构光临此盛会。**

### 主办单位及联络资讯：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会    王晓艳    029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会        李 琼    021-54179011-605

### 承办单位：

江苏东材新材料有限责任公司

### 协办单位：

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

广东省电路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

江西省电子电路行业协会（JXPCA）

## 赞助单位：（征集中）

江苏东材新材料有限责任公司	山东圣泉新材料股份有限公司
南亚新材料科技股份有限公司	浙江华正新材料股份有限公司
龙宇电子（梅州）有限公司	广东盈华电子材料有限公司
无锡华美科技有限公司	彤程新材料集团股份有限公司
广东生益科技股份有限公司	陕西宝昱科技工业股份有限公司
同宇新材料（广东）股份有限公司	咸阳威迪机电科技有限公司
建滔积层板控股有限公司	珠海镇东有限公司
南通图海机械有限公司	成都科宜高分子科技有限公司
江苏华伦化工有限公司	南通凯迪自动机械有限公司
淮北绿洲新材料有限责任公司	无锡赫普轻工设备技术有限公司
苏州巨峰新材料科技有限公司	广东亚镭机电工程有限公司
重庆德凯实业股份有限公司	无锡伟一不锈钢有限公司
水云天（天津）生物科技发展有限公司	杭州博野精密工具有限公司
江西省航宇新材料股份有限公司	苏州创蓝新材料有限公司
陕西硕博电子材料有限公司	江东电子材料有限公司

## 会议日程：

“第二十三届中国覆铜板技术研讨会”：会期 2023 年 2 月 16 日~18 日。2 月 16 日全天报到，2 月 17 日全天报告（8:30~18:00），2 月 18 日疏散。

## 会议费用：

**费用包括：**会务费、资料费、餐饮费等。

**会费标准：**已交会员费单位 1500 元/人，未交会员费单位代表及非会员单位代表 2000 元/人。参会代表可提前将会务费汇至协会账户，如参会人员有变动，会后办理退费或报到现场补交。

**住 宿：**参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间，标间 360 元/晚/间（含双早），单间 360 元/晚/间（含双早），费用自理。

**预定住宿联系人：**周凌云 电话：13776998688。

## 付款方式：

**帐 户：**中国电子材料行业协会

**开户银行：**工行北京香河园支行

**账 号：**0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

**会议地址：**

海安王府邦瑞国际大酒店，地址：江苏省海安市通榆中路 101 号。

酒店联系电话：0513-81856666 。

**会议酒店交通指南：**

**飞 机：**南通兴东机场，扬州泰州机场，盐城南洋机场，距离酒店约 1 个小时车程。

**高 铁：**乘高铁至海安火车站，距离酒店 5 公里，打车约 10 分钟；

**会务组联络方式：**

**联系人：** 王晓艳 13609146084 ， 029-33335234

董榜旗 15667263899

**协会微信：**15667246308

**E-mail：** ccla33335234@163.com

**网 站：** www.chinaccl.cn

第二十三届中国覆铜板技术研讨会组委会

2023 年 1 月 10 日



## “第二十三届中国覆铜板技术研讨会” 会议回执

单位名称					订房数量	
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	单人间	双人间

开票信息： 名 称：  
 纳税人识别号：  
 地 址 电 话：  
 开户行及账号：  
 发票邮寄地址：

备注	<p>房源有限，计划在海安王府邦瑞国际大酒店住宿的代表，务请于2023年2月12日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：周凌云          电话：13776998688。</p> <p>1. 请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于2月12日前发至 <a href="mailto:ccla33335234@163.com">ccla33335234@163.com</a> 或协会微信：15667246308。</p> <p>2. 需要了解研讨会最新动态请登录：<a href="http://www.chinaccl.cn">www.chinaccl.cn</a> 或者直接联系会务组。</p>
----	---

## 2023年2月17日会议日程表

时间	报告地点、报告人及报告题目	主持人
<b>报告地点（酒店四楼五福厅）</b>		
8:30 ~ 12:00	中国电子材料行业协会副理事长、覆铜板材料分会理事长 <b>张东</b> 致开幕词	张东
	中国电子电路行业协会副理事长、覆铜板分会会长 <b>陈仁喜</b> 致词	
	江苏省海安市领导 <b>致词</b>	
	四川东材科技集团股份有限公司总经理、江苏东材新材料有限责任公司总经理 <b>李刚</b> 致欢迎辞	
	颁发2022年“CCLA杯优秀论文奖”	
	海安市招商推介 <b>待定</b>	
	<b>【特邀报告】</b> 中国电子科技集团公司第14研究所研究员级高级工程师 <b>杨维生</b> 疫情·材料·悟道	
	<b>【特邀报告】</b> 四川大学高分子科学与工程学院学术院长、教授、博导 <b>傅强</b> 高功率射频微波用高性能覆铜板制备关键技术	
	<b>【特邀报告】</b> 中电材协覆铜板材料分会副秘书长 <b>祝大同</b> 对碳氢类覆铜板用树脂组成物相容性与可控性的讨论	
	山东艾蒙特新材料有限公司总经理 正高级工程师 <b>黄杰</b> 覆铜板用电子树脂的开发与应用	
奥沙达公司（前龙沙公司特种化学品部门）业务拓展经理 <b>宋春朋</b> 用于覆铜板、封装以及电子应用的新型热固型树脂		
12:00 ~ 13:30	<b>自助餐（一楼乐口福餐厅）</b>	董榜旗 赵学伟
<b>覆铜板产品与技术报告专场（酒店四楼五福厅）</b>		
14:00 ~ 18:00	无锡华美科技有限公司 总经理 <b>王忠</b> 超硬耐磨复合钢板的突破与机遇	杨中强
	西安交通大学微电子学院 研究生 <b>陈寅</b> 毫米波段覆铜板基材介电性能的各向异性测试方法研究	
	广东生益科技股份有限公司 技术开发工程师 <b>张秋</b> 改善PPO体系覆铜板剥离强度的硅烷偶联剂技术研究	
	陕西生益科技有限公司 工程师 <b>霍翠</b> Dk10.2/Df0.002高介电聚合物基高频覆铜板开发及性能研究	
	南亚新材料科技股份有限公司 高级工程师 <b>李兵兵</b> 含硅马来酰亚胺的研究及其在低介电和低膨胀系数覆铜板的应用	
	浙江华正新材料股份有限公司 研发部经理 <b>朱全胜</b> 112G板材用极低损耗覆铜板开发及PCB应用	
	山东理工大学材料科学与工程学院 研究生 <b>孙玉梅</b> 12 $\mu$ m铜箔的退火组织与性能	
	<b>【特邀报告】</b> 国家电子电路基材工程技术中心、广东生益科技股份有限公司 首席技术专家 覆铜板行业技术委员会 主任 <b>杨中强</b> 全球刚性覆铜板市场现状与技术发展	
<b>覆铜板用原材料报告专场（二楼锦绣前程厅）</b>		
14:00 ~ 18:00	中国科学院化学研究所，极端环境高分子材料实验室 博士、副研究员 <b>袁莉莉</b> 低轮廓铜箔与液晶聚合物薄膜黏结和射频性能研究	师剑英
	教育部纳米矿物材料及应用工程研究中心、中国地质大学（武汉）材料与化学学院教授 <b>曾鸣</b> 基于天然来源的光敏性苯并噁嗪及其高性能热固性树脂的制备与性能研究	
	中国科学院长春应用化学研究所 博士 <b>杨正慧</b> 基于透明聚酰亚胺的挠性覆铜板的制备与性能研究	
	国家绝缘材料工程技术研究中心、四川东材科技集团股份有限公司研究院院长、博士、高级工程师 <b>周友</b> 联苯型纳迪克酰亚胺的合成及其性能研究	
	山东圣泉新材料股份有限公司 工程师 <b>边均娜</b> 双环戊二烯苯酚环氧树脂国产化替代开发及市场推广	
	江西省航空新材料股份有限公司 研发工程师 <b>冯利斌</b> 一种耐黄变Mini-LED用白色覆铜板的开发	
	<b>【特邀报告】</b> 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 高级顾问 <b>师剑英</b> 我国碳氢覆铜板现状及发展趋势	
18:30 ~ 20:30	<b>江苏东材新材料有限责任公司 招待晚宴</b>	赵学伟